

113 年「半導體封裝測試工程師人才培育計畫」課程

日期：113 年 6 月 1 日（六）和 113 年 6 月 2 日（日）

地點：明新科技大學逢喜樓 209 教室及半導體人才培育基地（新竹縣新豐鄉新興路 1 號）

時間：09:30~18:30（報到時間 09:00~09:30，中午休息時間 12:30~13:30）

人數：25 人（皆為實體，無線上授課）

活動內容：



報名連結

日期	時間	課程名稱	授課教師	地點	
6/1 (六)	09:00~09:20	報到		明新科技大學 逢喜樓 209 教室	
	09:20~09:30	致詞	明新科技大學 半導體學院 張合院長		
	09:30~12:30	半導體製程概論	明新科技大學 半導體學院 趙守嚴副院長		
	12:30~13:30	午餐			
	13:30~17:30	晶圓切割機操作實務	力成科技股份有限公司 何信松 資深工程師		明新科技大學 半導體人才培育基地
	17:30~18:30	Q & A			
6/2 (日)	09:00~09:30	報到		明新科技大學 半導體人才培育基地	
	09:30~12:30	黏晶機操作實務	力成科技股份有限公司 林賢昇 資深工程師		
	12:30~13:30	午餐		明新科技大學 逢喜樓 209 教室	
	13:30~17:30	打線機操作實務	力成科技股份有限公司 黃志賢 資深工程師	明新科技大學 半導體人才培育基地	
	17:30~18:30	Q & A			

備註：

1. 本次研習課程為期 2 天，需參與全程課程，且符合報名資格者（全國各大專校院在學學生），將於課程結束後核發研習時數證明。
2. 填寫並提交課程報名表單後即可視為報名成功，若後續因報名資格不符或額滿等因素而無法錄取，主辦單位將提前另外以 Email 通知。
3. 主辦單位保留報名資格審核權，修改或變更活動內容及額滿提前截止報名之權利。
4. 本研習為免費課程，報名者無須負擔報名費。
5. 6/1（六）和 6/2（日）兩天將於課前和課後提供交通接駁往返臺北車站及上課地點，請於報名表單中填寫是否搭乘接駁車。

活動聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學 盧專員

連絡電話：(02)2771-2171 分機 6020，E~mail：hund@mail.ntut.edu.tw